

证券代码：688596
转债代码：118053

证券简称：正帆科技
转债简称：正帆转债

公告编号：2026-017

上海正帆科技股份有限公司

2025 年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和高质量发展，公司于 2025 年 4 月 29 日披露了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，通过持续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信任，维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展。

2025 年度，公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措，现将 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的实施和效果评估情况及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、 聚焦公司主业，保持业务稳步发展

正帆科技长期以来致力于服务中国集成电路、泛半导体、新材料和新能源等先进制造业以及生物制药等高科技产业，向客户提供制程关键系统、核心工艺材料与零组件、专业运维管理的“三位一体”服务。公司秉承着以客户为中心的经营理念，致力于为集成电路及泛半导体等高科技产业客户提供平台式综合服务。近年来，通过持续的技术创新与产能优化布局，公司凭借非设备类业务的增长势头，推动业务结构不断升级完善。

报告期内，面对复杂多变的市场环境，公司董事会和管理层积极应对，扎实做好公司日常生产经营。2025 年，公司实现营业收入 49 亿元，同比下降 10%；

归属于母公司所有者的净利润 1.36 亿元，同比下降 74%。公司收入和净利润下滑的主要原因包括：报告期内，受部分下游行业资本开支节奏放缓、市场竞争加剧及部分项目延期交付等因素影响，公司收入与毛利承受阶段性压力。

随着行业景气度回升，公司将持续推动制程关键系统、半导体设备零组件、气体和先进材料业务的效益释放，叠加对成本和费用的精细化管控，预计公司 2026 年盈利能力有望改善。

2026 年，公司将主要从以下方面着力继续提升自身的竞争力：

1.发挥内部协同作用，推进半导体零部件/材料平台功效释放

随着汉辽宁汉京半导体材料有限公司（以下简称“汉京半导体”）2025 年完成并表，2026 年将重点推进协同效应释放与产能爬坡：推动汉京半导体的石英/SiC 耗材与鸿舸半导体设备（上海）有限公司的 Gas Box 模组业务，在客户资源、技术认证与供应链层面形成协同效应，提升对客户的服务能力；加速汉京半导体产线产能利用率提升，推动高纯石英、碳化硅部件在先进制程领域的规模化应用。同时，推进可转债募投项目建设，推动合肥高纯氢气项目、潍坊高纯大宗项目产能持续爬坡，加速铜陵二期项目的量产准备工作及客户导入。

2.坚定出海战略，强化海外市场拓展力度

2025 年海外业务拓展已初见成效。2026 年公司将持续推进出海战略，依托制程关键系统与设备、气体及先进材料的完整产品体系，在东南亚、中东、北美等新能源高需求地区建立本地化销售网络与服务团队，扩大光伏、新材料等先进制造业领域的海外市场份额；同时逐步推进半导体行业客户的技术认证与项目落地，实现海外业务规模与质量的同步提升。

3.推进同源技术跨行业外溢，开辟可持续增长新赛道

基于超高纯流体控制、微污染控制、精密材料加工等底层技术的泛用性，公司将持续向新能源、新材料等先进制造业拓展业务边界。在新能源和新材料领域，重点向固态电池硅碳负极材料、氢能装备、精细化工、科研实验室需求以及其他方向拓展。通过技术平台的模块化改造与工艺参数适配，实现半导体级技术向新兴产业的降维应用，在分散单一行业周期风险的同时，积累新的技术 know-how 与客户资源，构建多极增长格局，为公司长期发展注入可持续动能。

4.持续提升组织效能，支撑多元化业务协同运营

围绕多元化业务架构，公司将系统性提升组织效能以匹配战略扩张需求。管理机制层面，优化跨事业部协同机制，建立客户资源、供应链与技术平台的共享中台，打破信息孤岛，实现各业务板块的高效协同；数字化层面，深化 AI 中台与 CRM、ERP、MES 等核心业务系统的集成应用，通过数据互通实现精准排产、智能库存管理与预测性维护，降低运营成本；人才与激励层面，完善适配公司业务特性的绩效考核体系，强化运营效率、客户服务质量与长期价值创造导向，持续实施股权激励与员工持股计划，确保核心管理团队与技术研发骨干的稳定性，为业务发展提供组织保障。

二、 坚持科技创新，提高核心竞争力

持续研发提升产品竞争力是企业取得成功的关键之一，公司始终坚持以创新研发为主，提高自主创新能力，已形成六项底层核心技术，报告期内，公司完成并购汉京半导体，新增两项核心技术，碳化硅加工技术和火加工技术。

2025 年度，公司研发费用占营业收入的 6.68%，截至报告期末，公司已累计获得知识产权数量合计 560 项，其中发明专利 107 项，实用新型专利 339 项，外观专利 29 项，软件著作权 85 项。

2026 年，公司将继续坚持加大研发投入，通过深入了解终端客户需求，不断提升产品的关键性能以满足客户更新迭代的工艺技术需求，持续提高公司综合研发能力，增厚公司技术储备，为公司的持续发展提供强有力的保障。

三、 积极回报投资者

公司高度重视股东回报，严格执行利润分配政策，通过股份回购、利润分配等方式，致力于为投资者带来长期、稳定的投资回报。公司自上市以来严格执行并落实公司制定的分红回报规划，积极回报投资者，2023 年-2025 年累计现金分红合计 192,145,967.56 元，占最近三个会计年度平均净利润 355,130,392.25 元的 54.11%，其中 2025 年现金分红金额待股东会审议通过后实施。

2026 年，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，结合公司实际经营情况、发展战略规划以及行业发展趋势，制定科学、持续、稳定的投资回报规划与机制，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，努力实现公司价值和股东利益最大化。

四、 完善公司治理，促进规范运作

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，将持续完善法人治理和内部控制制度，建立以股东会、董事会和下设委员会及经营管理层为主体结构的经营与决策管理体系，形成了权责明确、各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调的法人治理结构，保护公司及全体股东的利益。为进一步促进公司规范运作，2025年11月28日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。公司根据相关规定，提升规范运作水平，结合公司实际情况，公司对《公司章程》等多项公司治理制度进行了修订、制定。

在今后的工作中，公司将结合自身实际情况，及时对公司内部治理相关制度进行梳理更新，提升公司制度执行的有效性。同时，公司将保持与实控人、控股股东、董事、高级管理人员等关键少数的密切沟通，监督相关方承诺履行情况，加强对相关人员进行法律法规相关培训。

五、 人才成就未来，构建人才战略

公司多年来一直坚持自己独特的企业基因，倡导努力创造条件成就高潜质员工的成功。公司创造一切条件帮助高潜质人才快速成长并获取最大个人价值。公司持续推行和完善包括期权计划、员工持股计划等在内的各项激励机制，鼓励优秀员工把自己的利益与公司的长远利益捆绑在一起，为共同的目标而奋斗。公司的激励机制，不仅助推了大量内部员工的成长，还吸引了大量外部高级人才的加入，为公司持续创新和快速发展带来不竭的源泉。公司将继续按照未来发展战略目标，加强人力资源储备、专业队伍建设和人才引进，提升管理水平强化考核与激励机制，提高公司人才竞争力。

六、 加强投资者关系管理，提高信息披露质量

公司通过召开业绩说明会、上证e互动及投资者热线等途径积极与广大投资者沟通，同时公司高度重视投资者关系管理，董事长、总经理以及高管团队通过投资者现场调研、举办线上投资者交流会、反路演交流会等各种形式不断向各类投资者传递公司投资价值。

公司高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，认真做好信息披露工作，公司将继续提升对信息披露的重视程度，加强对信息披露相关法律法规的研习，从投资者视角出发，持

续提高信息披露质量；2025年，公司在发布定期报告后，及时采取图文简报、召开3次业绩说明会等可视化形式，对定期报告和临时公告进行解读，便于投资者理解，并持续通过自愿性公告、e互动问答、投资者关系热线、IR邮箱等途径加强与广大投资者的沟通交流，听取投资者的意见建议，并在法规允许的范围内做出及时回应。

七、 总结

2025年度，公司积极实施“提质增效重回报”行动方案，有力推动了自身高质量发展。公司始终围绕主营业务这一核心，持续对运营管理进行优化，全方位提升经营质量。同时，大力加强投资者关系的管理与维护工作，切实保障了投资者的合法权益。2026年度，公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力，通过规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象。

本报告是基于目前公司的实际情况而做出的判断，未来可能会受到政策调整、市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2026年4月18日